No.	Histor	У	Version	Owner
1 2	First Issue 增加 SOT23-3 封装形式;修改产品选型	型和打标信息;以及包装卷盘信息	1.0 1.1	Lemon Lee
	Signature QA:	Date:		
	AE:	Date:		
	FAE:	Date:		
	PD: Date:			
	R&D: Date:			
	Market: Date:			
	GM: Date:			

■ 概述

JC75HXX系列是专为功耗敏感应用研发设计的一款高输入电压、超低功耗的低压差线性稳压器。

最大允许的输入电压可达35V,且输出100mA电流时输入输出电压差仅300mV。典型情况下,静态电流1.6µA,具有几个固定的输出电压1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,3.6V,4.0V,4.2V,5.0V。

IC内部集成了短路保护和热关断功能。

尽管主要为固定电压调节器而设计,但这些 IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。

■ 应用

- ▶ 电池供电设备
- ▶ 烟雾传感器
- ▶ 微控制器
- ▶ 家用电器与仪器

■ 特点

- ▶ 超低静态电流 1.6uA
- ▶ 宽输入电压范围 Vour+1V 至 35V
- ▶ 大输出电流≥200mA
- 系统启动无过冲
- ▶ 短路保护释放无过冲
- ▶ 低压降

30mV@10mA 300mV@100mA 600mV@200mA

- ▶ 多种固定输出电压: 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V
- ▶ 输出电压精度:

JC75HXX ±2%

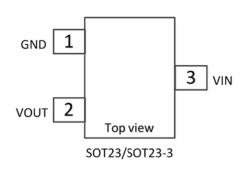
- ▶ 较好的电源/负载瞬态响应
- ► 低温度漂移±100ppm/℃
- ▶ 短路保护功能
- ▶ 过热保护功能
- ▶ 多种封装类型,适合不同应用需要

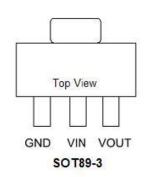
JC75HXXSC	SOT23
JC75HXXTE	SOT23-3
JC75HXXTG	SOT23-5
JC75HXXTS	SOT89-3
JC75HXXTY	TO92

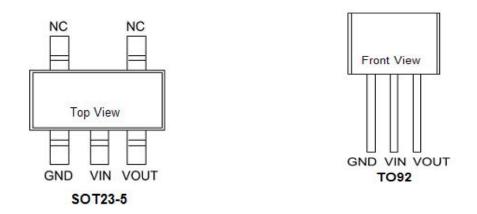
■ 引脚定义

	Pin	Symbol	Description	
SOT23	SOT23-5/SOT89-3/TO92	Symbol	Description	
1	1	GND	系统地电位,接输入电源的负端,用电设备供	
	I .	GND	电的负端,以及输入电容和输出电容的负极	
2	3	VOUT	线性稳压器的输出,接输出电容正极以及用电	
	3	VO01	设备供电的正端	
3	2	VIN	线性稳压稳压器的输入正端,接输入电源的正	
3	2		端,以及输入电容的正极	

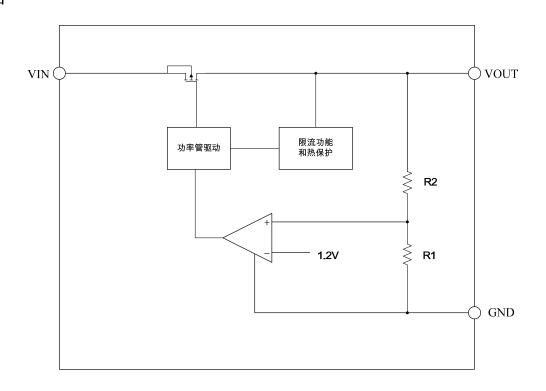
■ 封装形式及引脚分布







■ 方框图



■ 绝对最大额定参数

Characteristics	Description		Min Max	
	VIN脚对GND脚的耐压	-0.3	40	V
电压	VOUT脚对GND脚的耐压	-0.3	6	V
	VOUT脚对VIN脚的耐压	-35	0.3	V
电流	峰值电流	内	部限流300m	A
	工作环境温度	-40	120	$^{\circ}$
温度	存储温度	-40	150	$^{\circ}$
	最大结温	-	150	$^{\circ}$
	SOT23	35	350	
++**	SOT23-3 SOT23-5	26	260	
封装热阻 -	SOT89-3	16	165	
	TO92	18	180	
	SOT23	35	50	mW
	SOT23-3	42	420	
封装最大允许功耗	SOT23-5	48	480	
	SOT89-3	50	500	
	TO92	45	450	
見近熱力変光光	人体模式(HBM)	-	5	kV
最低静电释放能力 -	机械模式 (MM)	-	500	V

注:超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预料芯片在额定参数范围外的工作状态,而且若长时间工作在额定参数范围外,可能影响芯片的可靠性。

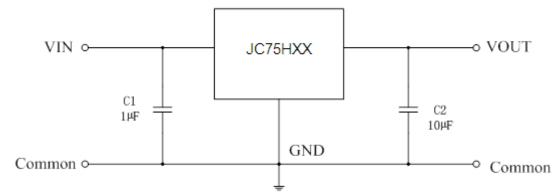
■ 电气参数(除特殊说明外,以下参数均在 TA=25°C,C_{IN}=1uF,V_{IN}=V_{OUTNOM}+1V,C_{OUT}=10µF 条件下测试)

Symbol	Characteristics	Conditions	Min	Тур.	Max	Unit
V _{IN}	输入电压		3		35	V
I _{GND}	静态电流	无负载		1.6	2.0	μA
V _{OUT(} JC75HXX ₎	输出电压	1 =10mA	-1%		1%	V _{OUT}
V _{OUT(} JC75HXX)	制出电压	I _{OUT} =10mA	-2%		2%	V _{OUT}
I _{OUT}	输出电流		1	250	_	mA
		I_{OUT} =10mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	30	50	mV
	Dropout电压*1 (JC75H50)	I_{OUT} =100mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	300	400	mV
V		I_{OUT} =200mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	600	750	mV
V_{DROP}		I_{OUT} =10mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	30	50	mV
	Dropout电压 (JC75H33)	I_{OUT} =100mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	300	400	mV
	(1.1.1.1)	I_{OUT} =200mA ΔV_{OUT} = - V_{OUTNOM} *2%	_	600	750	mV
ΔV_{OUT}	负载调整率	1mA≤l _{OUT} ≤100mA	_	20	50	mV
$\Delta V_{OUT} x 100/$ $\Delta V_{IN} x V_{OUT}$	输入电压调整率	I _{OUT} =1mA, V _{IN} =(V _{OUTNOM} +1V) to 30V	_	_	0.2	%/V
I _{LIMIT}	限流保护	V _{IN} =(V _{OUTNOM} +1V) to 30V R _{LOAD} =V _{OUTNOM} /1A		280	300	mA
T _{SHDN}	过热保护			125		$^{\circ}\!\mathbb{C}$
TC _{VOUT}	温度系数	I _{OUT} =10mA -40°C≤TAMB≤100°C		±100		ppm/℃

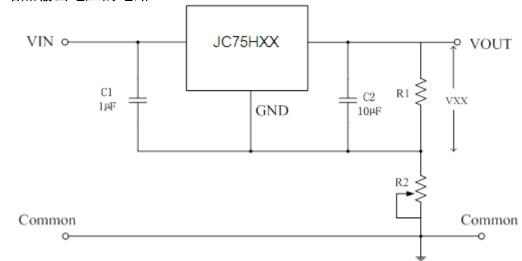
注: *1 Dropout 电压定义为输出电压较其标称值下降 2%时对应的输入输出电压差。

■ 应用电路

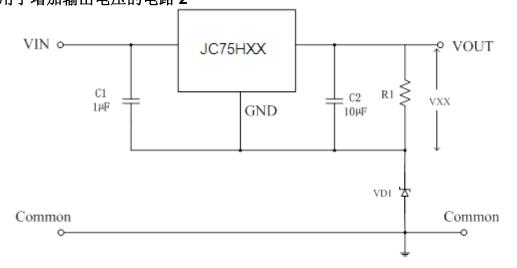
典型应用电路



用于增加输出电压的电路 1



▶ 用于增加输出电压的电路 2



■ 应用说明

> 功耗计算

内置功率管的功耗 P_D(MOSFET)=(V_{IN}-V_{OUT})*I_{OUT}

芯片整体功耗 PD(TOTAL)=PD(MOSFET)+VIN*IGND

静态电流 I_{GND} 为 1.6uA, V_{IN}*I_{GND} 功耗可忽略不计,因此最坏情况的功耗为:

 $P_{D}(max) = [V_{IN}(max) - V_{OUT}(min)] * I_{OUT}$

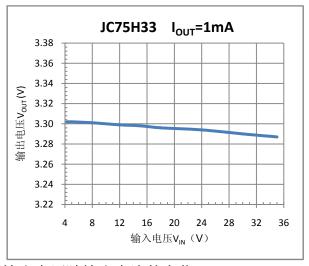
▶ 结温

 $T_J=P_D(max)^*\theta_{JA}+T_A$

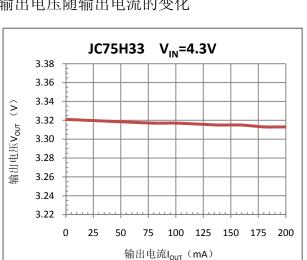
式中 θ_{JA} 表示封装热阻, T_A 表示环境温度。

典型性能特点

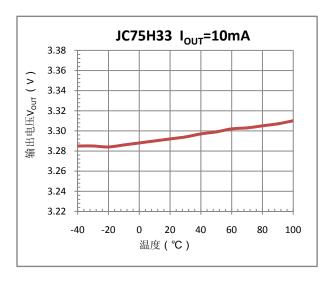
输出电压随输入电压的变化

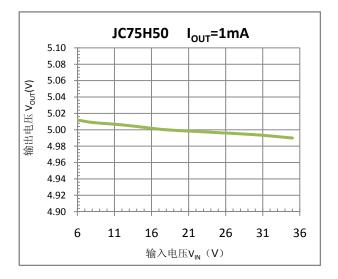


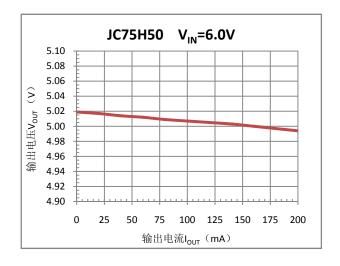
输出电压随输出电流的变化

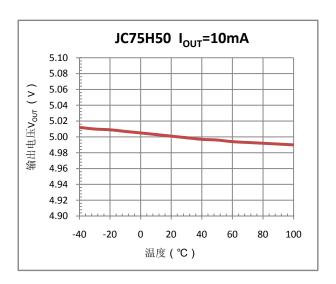


输出电压随温度的变化

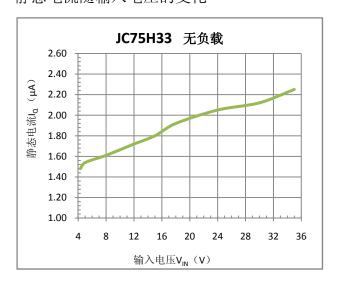


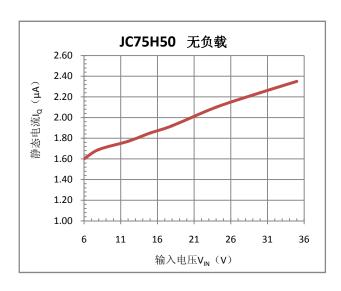




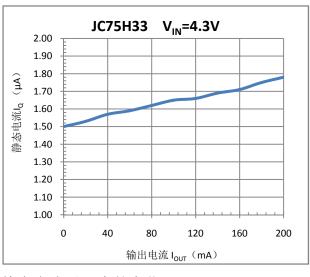


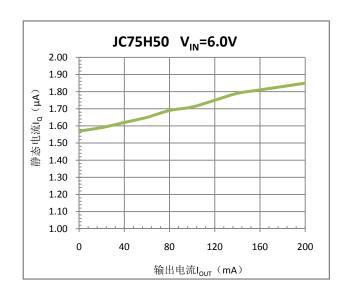
静态电流随输入电压的变化



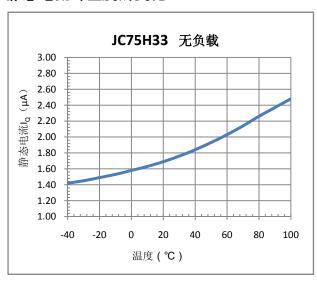


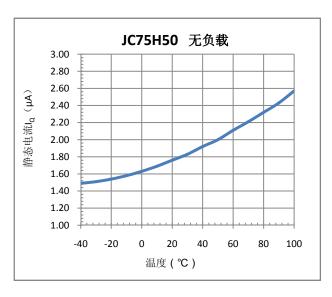
静态电流随输出电流的变化



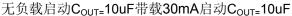


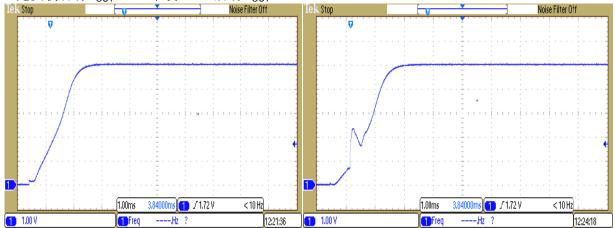
静态电流对温度的变化



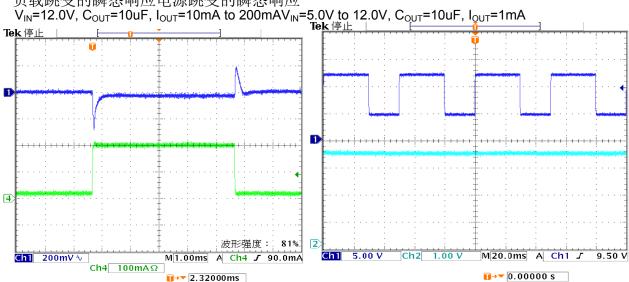


系统空载和带载启动

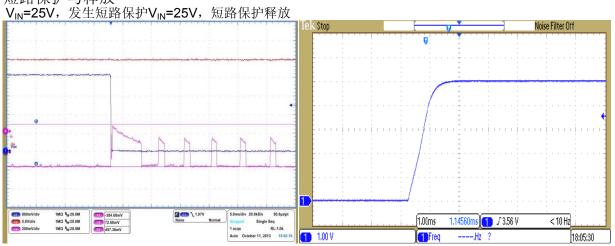




负载跳变的瞬态响应电源跳变的瞬态响应



短路保护与释放



■ 产品选型

本日刊 日					包装方式及最	的订货数量	
产品型号 (XX: 封装形式代码)	最高输入电压(V)	输出电压 (V)	精度	SOT23 代码:SC	SOT23-5 代码:TG	SOT89 代码:TS	TO92 代码:TY
JC75H18AXX	35V	1.8	1%				
JC75H18BXX	35V	1.8	2%				
JC75H25AXX	35V	2.5	1%				
JC75H25BXX	35V	2.5	2%				
JC75H30AXX	35V	3.0	1%				
JC75H30BXX	35V	3.0	2%				
JC75H33AXX	35V	3.3	1%				1000/袋
JC75H33BXX	35V	3.3	2%	3K/卷盘	3K/卷盘	1K/卷盘	1000/衰 10K/盒
JC75H36AXX	35V	3.6	1%				1010 <u>ш.</u>
JC75H36BXX	35V	3.6	2%				
JC75H40AXX	35V	4.0	1%				
JC75H40BXX	35V	4.0	2%				
JC75H42AXX	35V	4.2	1%				
JC75H42BXX	35V	4.2	2%				
JC75H50AXX	35V	5.0	1%				
JC75H50BXX	35V	5.0	2%				

■ 打标信息

SOT89-3/TO92 打标

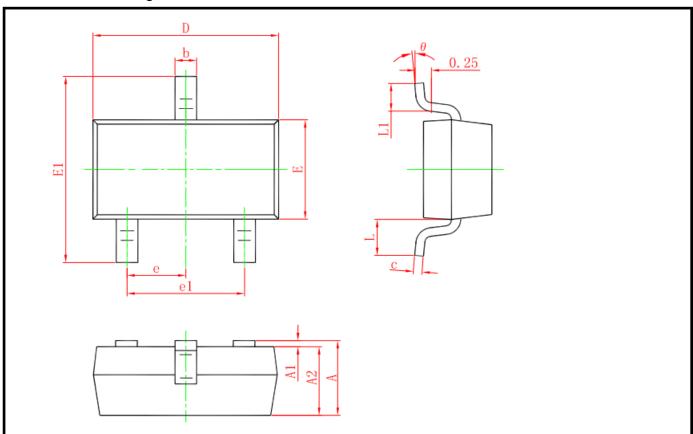


SOT23/SOT23-5 打标



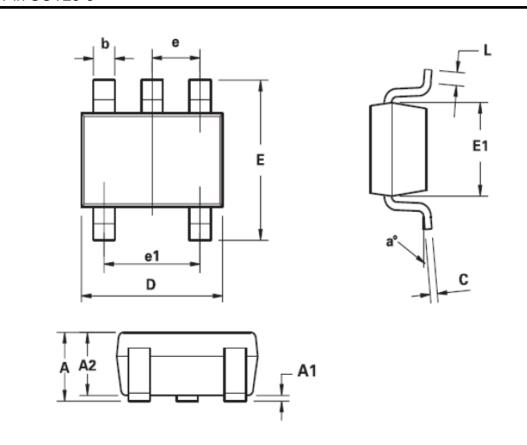
■ 封装信息

3-Pin SOT23 Package



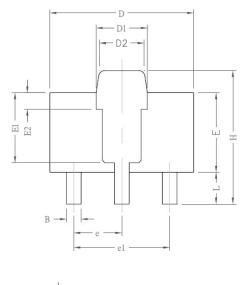
Symbol	Dimensions	Dimensions In Millimeters		s In Inches
Symbol	Min.	Max.	Min.	Max.
Α	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
С	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
е	0.950	TYP.	0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022	REF.
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0° 8° 0°		8°	

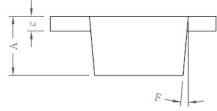
5-Pin <u>SOT23-5</u>

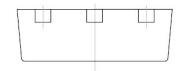


DIM	Millin	neters	Inches		
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Α	0.90	1.45	0.0354	0.0570	
A1	0.00	0.15	0.00	0.0059	
A2	0.90	1.30	0.0354	0.0511	
b	0.20	0.50	0.0078	0.0196	
С	0.09	0.26	0.0035	0.0102	
D	2.70	3.10	0.1062	0.1220	
E	2.20	3.20	0.0866	0.1181	
E1	1.30	1.80	0.0511	0. 07 0 8	
e	0.95 REF		0.0374 REF		
e1	1.90	REF	0.0748 REF		
L	0.10	0.60	0.0039	0.0236	
a°	0°	30°	0°	30°	

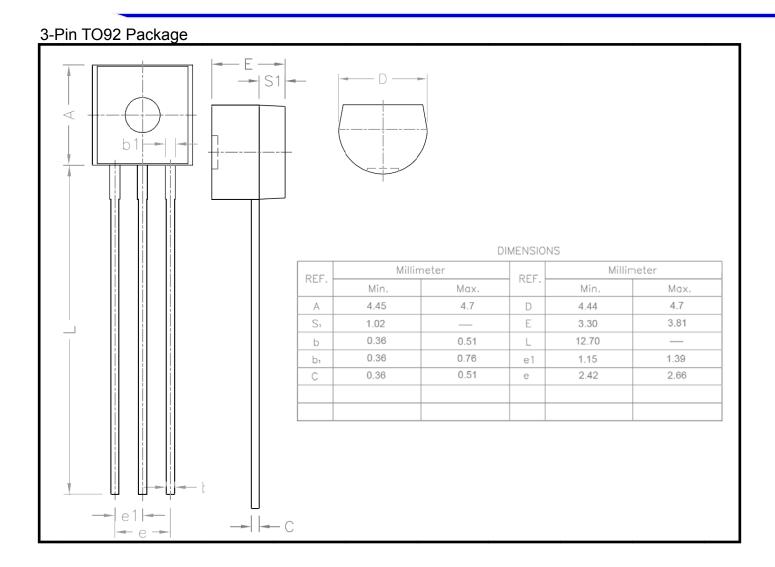
3-Pin SOT89-3 Package



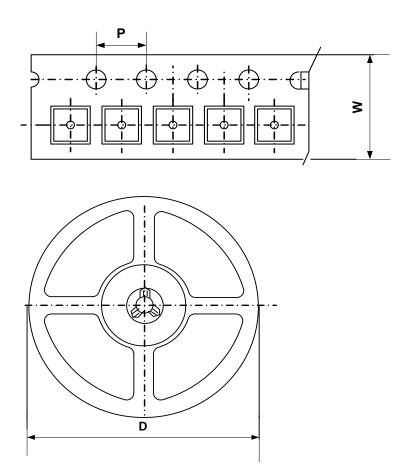




	DIMENSIONS				
REF.	Millim	eters			
	Min.	Max.			
А	1.40	1.60			
В	0.40	0.52			
С	0.35	0.41			
D	4.40	4.60			
D1	1.50	1.70			
D2	1.30	1.50			
Е	2.40	2.60			
E1	2.2 0	REF.			
E2	0.52	REF.			
е	1.50	REF.			
e1	3.00	REF.			
F	5°	TYP.			
Н	4.05	4.25			
L	0.89	1.20			



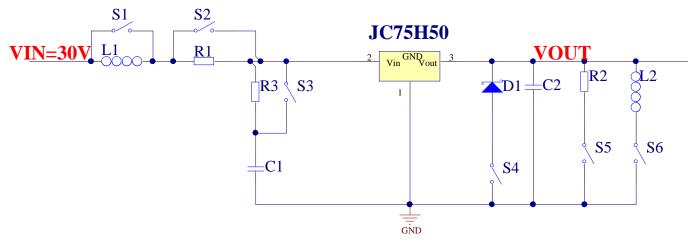
■ 卷盘编带规格



封装形式	载带宽度 W(mm)	间距 P(mm)	卷盘直径 D(mm)	最小包装数(pcs)
SOT23 SOT23-5	8.0±0.1 mm	4.0±0.1 mm	180±1 mm	3000pcs
SOT89-3	12.0±0.1 mm	4.0±0.1 mm	180±1 mm	1000pcs
TO92-3	1	1	1	1,000pcs/袋 10,000pcs/盒

应用指南:

- 1、 输出输入电容选取及输入电路设计
 - a、测试电路



b、测试条件及测试结果

S1,S2,S3 闭合

C1=10uF50V(电解电容),

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω

S6 开路

测试结果(1)蓝色 VOUT(2)红色 VIN(3)绿色输入电流 噪声滤波器关闭 < 10 Hz 400 Jus 200.000ns 200.000ns 1.00 V 2 10.0 V ■频率 11:12:17 -.Hz ? lek 预览 2,4950,us 18.3 A 499mA △17.8 A < 10 Hz 4.00 Jus 200,000ns 20 12,0 V 1.00 V 2 10.0 V ----.Hz ? 11:11:48

S1,S2,S3 闭合

C1=1uF50V(电解电容)

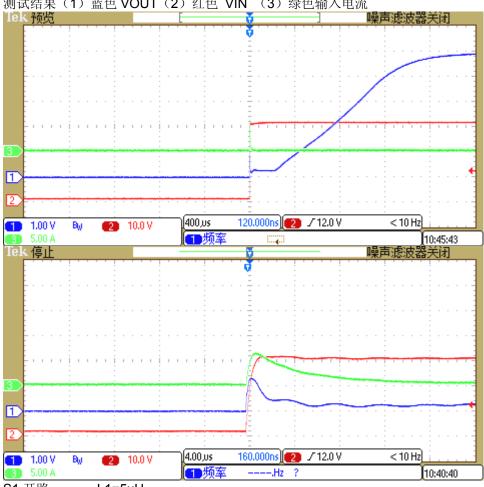
C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω

S6 开路

测试结果(1)蓝色 VOUT(2)红色 VIN(3)绿色输入电流



S1 开路, L1=5uH

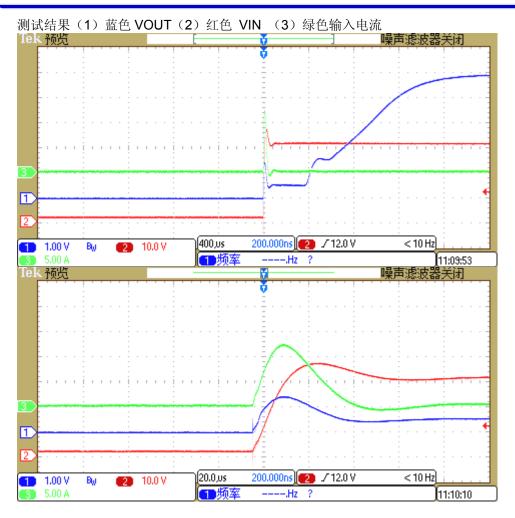
S2,S3 闭合

C1=10uF50V(电解电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω



S1 开路, L1=5uH

S2,S3 闭合

C1=1uF50V(电解电容)

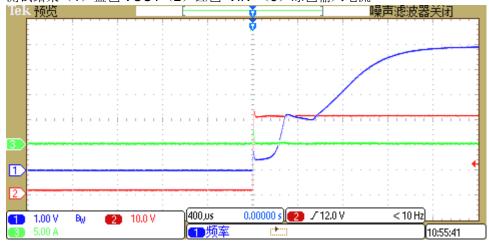
C2=10uF10V(电解电容)

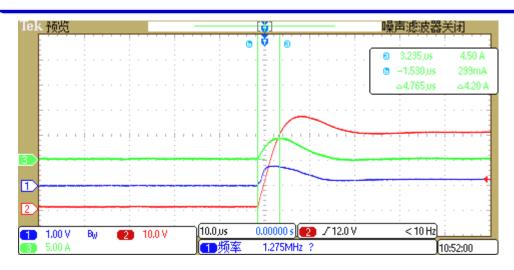
S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω

S6 开路

测试结果(1)蓝色 VOUT(2)红色 VIN(3)绿色输入电流





S1,S2,S3 闭合

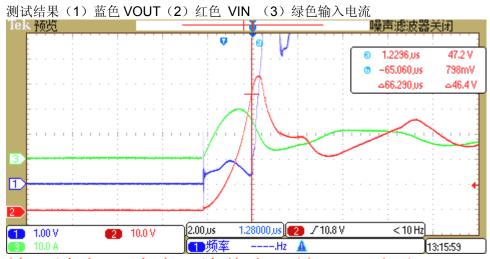
C1=1uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω

S6 开路



输入端电压过冲,峰值电压达 54V 左右, IC 过压击穿

S1,S2 闭合

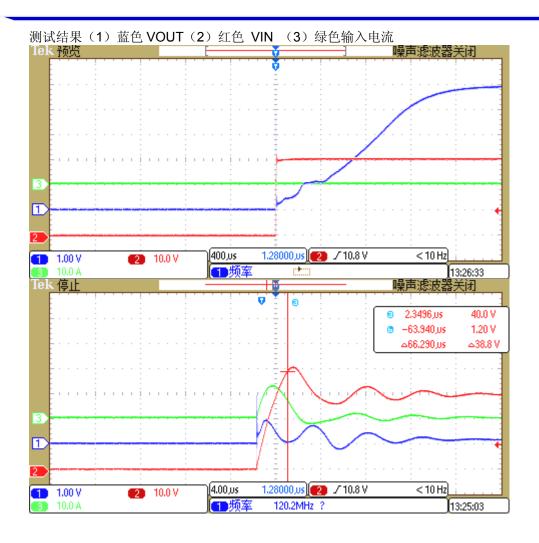
S3 开路 R3=1Ω

C1=1uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω



S1,S2 闭合

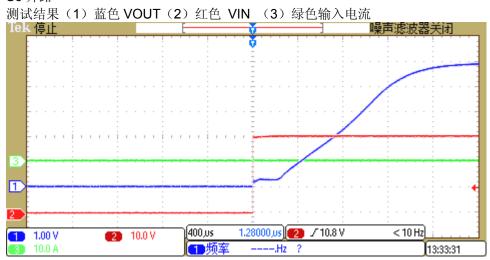
S3 开路 R3=10 Ω

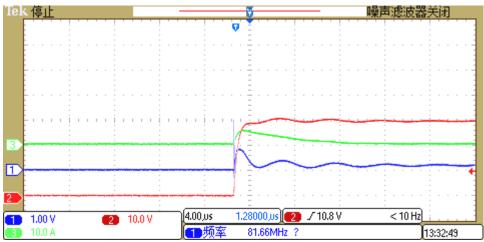
C1=1uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω





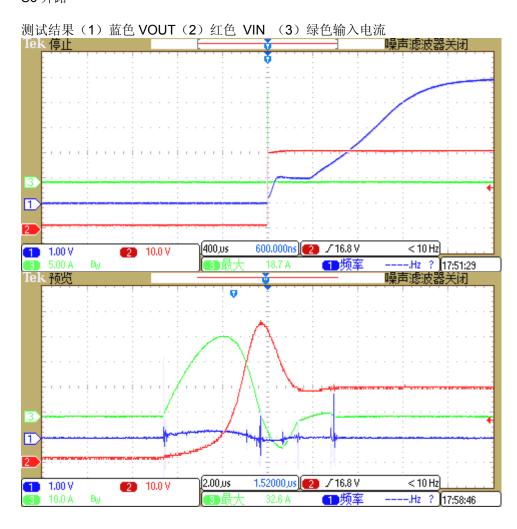
S1,S2,S3 闭合

C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω



S1,S2 闭合

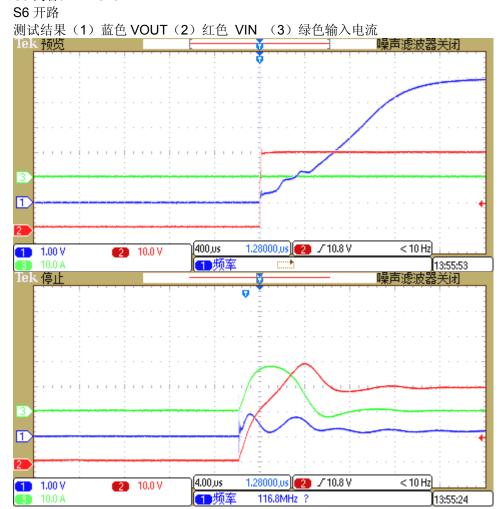
S3 开路 R3=1Ω

C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510Ω



S1,S2 闭合

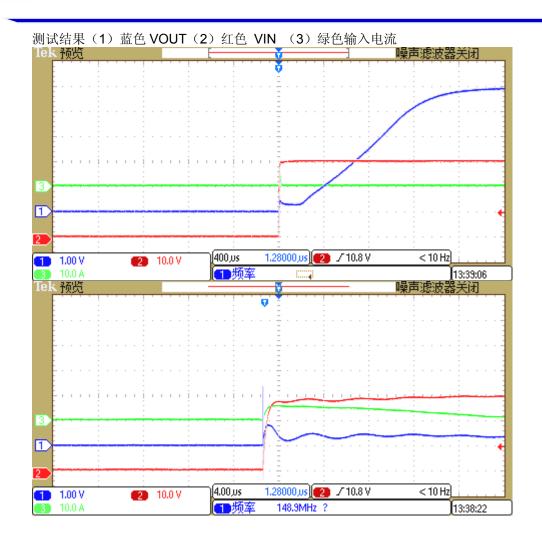
S3 开路 R3=10 Ω

C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合,R2=510 Ω



实验结论:

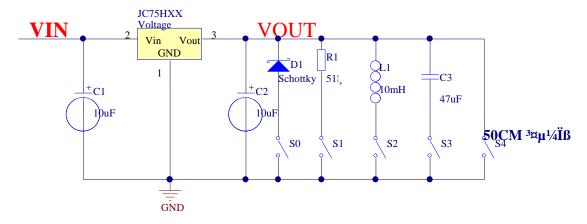
在输入电压上升较快的系统中,由于线路中寄生电感的原因,导致上电过程产生 LC 谐振,导致输入电压过冲,峰值最大可导致 2 倍输入电压,容易造成 LDO 过压击穿。

在实验过程做可以看出,选择 ESR 较大的电容(如电解电容),或串入一个 1-10 Ω 的电阻以降低风险(但需要注意电阻抗电流冲击能力选择),实验中可以看出,上电瞬间,不同容值电容充电电流可以达到几安至几十安。根据不同容值的电容,应该选择相应的阻值及电阻功率。

另外,寄生电感对电路可靠性产生极大影响,在 PCB 布线 及外接电源时,需尽量减小线路长度及考虑适当的走线方式,以减 小寄生电感的电感量。

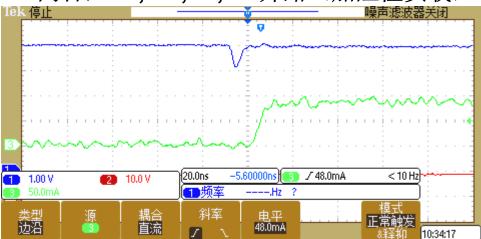
2、 输出短路或过载

a、测试电路

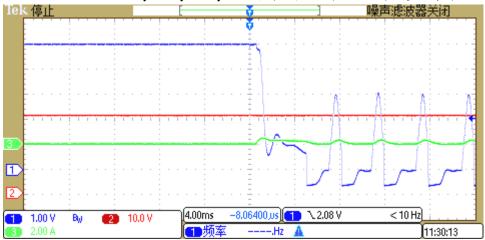


b、测试条件及测试数据

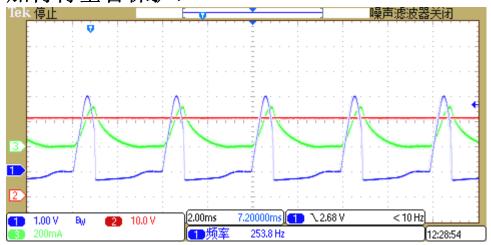
S1 闭合, S0, S2,S3,S4 开路(加阻性负载)



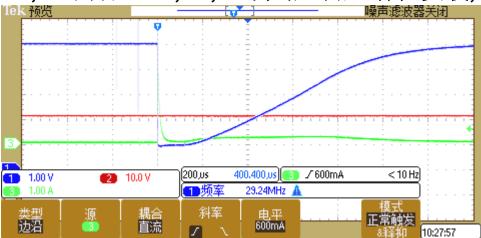
S2 闭合, S0,S1,S3,S4 开路(加感性负载,过载情况下)



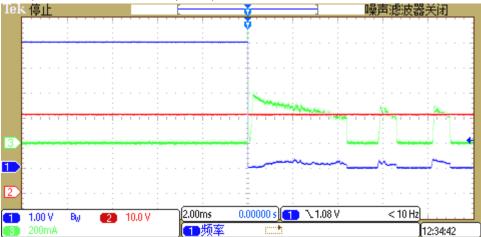
S0,S2 闭合, **S1,S3,S4** 开路(加感性负载,过载情况下,加肖特基管保护)



S0,S3 闭合,S1,S2,S4 开路(加纯容性负载,过载情况)



S0,S4 闭合, S1,S2,S3 开路(短路测试)

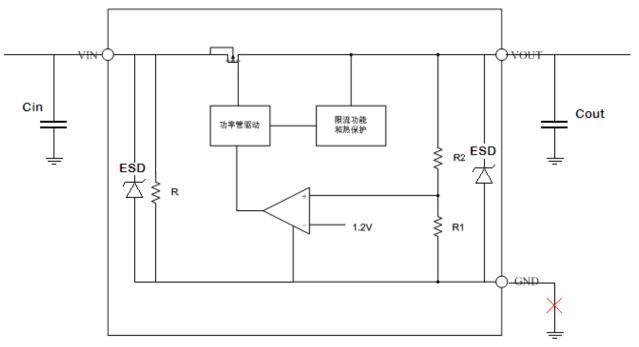


测试结论:

在应用过程中,使用感性负载(如直流电机,继电器,喇叭等)时,应该尽量避免过载。因为如果发生过载,LDO会进入过载保护,但是由于电感上电流不能突变,导致通过 LDO 输出端 ESD 器件续流,输出端产生负压,容易造成 ESD 器件损伤。在这种应用中,尽量增加肖特基二极管以保护 LDO的 ESD 器件。在短路测试时,需要考虑使用短路导线的长度,尽量减少寄生电感。以免造成 ESD 器件损伤。如果经过短路测试后,发现输出电压升高,则 ESD 器件已经受损。

在应用过程中,大的容性负载,在接通负载瞬间会导致输出电压被瞬间拉低,可能会导致应用电路不稳定。

3、 生产过程控制



LDO内部示意框图及基本外部电路

从内部框图及应用电路可以看出,如果 LDO 的 GND 脚与线路板的地线虚焊,在外部无负载时,会导致 VIN 电压通过 R,R1,R2 给 Cout 充电,使 Vcout=Vin。此时如果没有给 Cout 放电,直接补焊 GND pin,由于输出端 ESD 为 6.5V 保护器件,Cout 会通过 ESD 器件瞬间放电,导致 ESD 器件受损。所以,在生产过程中应该避免这种情况发生。